

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国海证券
会议时间	2024年12月10日14:00-15:00
会议地点	现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：半导体产业国产替代，崛起，超越，引领，不仅仅是企业的发展目标，更是国家安全自主战略的重要保障。请问贵公司在半导体行业国产化替代上做了哪些努力？</p> <p>回复：公司一直以成为优秀的半导体封装材料供应商为己任，专注于先进封装用环氧模塑料的研发及产业化，公司积极配合国内封测厂家，持续加大研发投入，抓住国产化替代机遇，努力拓展市场，服务好客户，争取早日实现国产化替代。</p> <p>问题二：请问先进封装包括哪些类型？</p> <p>回复：目前主要将工艺相对复杂、封装形式、封装技术、封装产品所用材料处于行业前沿的封装形式划分为先进封装，目前国内先进封装主要包括 QFN、BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封装形式。</p>

	<p>问题三：请问随着 HBM 堆叠层数的增加会不会改变 GMC 的使用量？</p> <p>回复：环氧模塑料的使用量主要与封装的设计和工艺有关。</p> <p>问题四：公司有哪些产品能够应用于 PCB 领域？</p> <p>回复：公司产品——电子胶黏剂可以用于 PCB 板级组装。</p> <p>问题五：请问公司产品可以用于汽车芯片生产吗？</p> <p>回复：公司的常规产品和无硫 EMC 可以用于汽车电子的封装。公司多年前已布局汽车电子行业，多款产品已实现批量销售。</p> <p>问题六：请问 MCM 封装有什么优劣势？公司有没有涉及该技术路线的封装材料？</p> <p>回复：MCM 封装形式多样，公司大部分有对应产品。公司的研发中心正致力于相关研究工作，并积极开发与之对应的产品。</p> <p>问题七：据传海力士 MR-MUF 热控技术取得突破，HBM 迈向新高度 MR-MUF 技术另一个重要特性是采用了一种名为环氧树脂模塑料（EMC, Epoxy Molding Compound）4 的保护材料，用于填充芯片间的空隙。EMC 是一种热固性聚合物，具有卓越的机械性、电气绝缘性及耐热性，能够满足对高环境可靠性和芯片翘曲控制的需求。请问公司的 EMC 是否可用于该技术？</p> <p>回复：MR-MUF 工艺采用的塑封料是新型液态塑封料，目前公司处于技术研发阶段，尚没有产品。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 10 日